

2019年3月期  
第2四半期 決算説明会

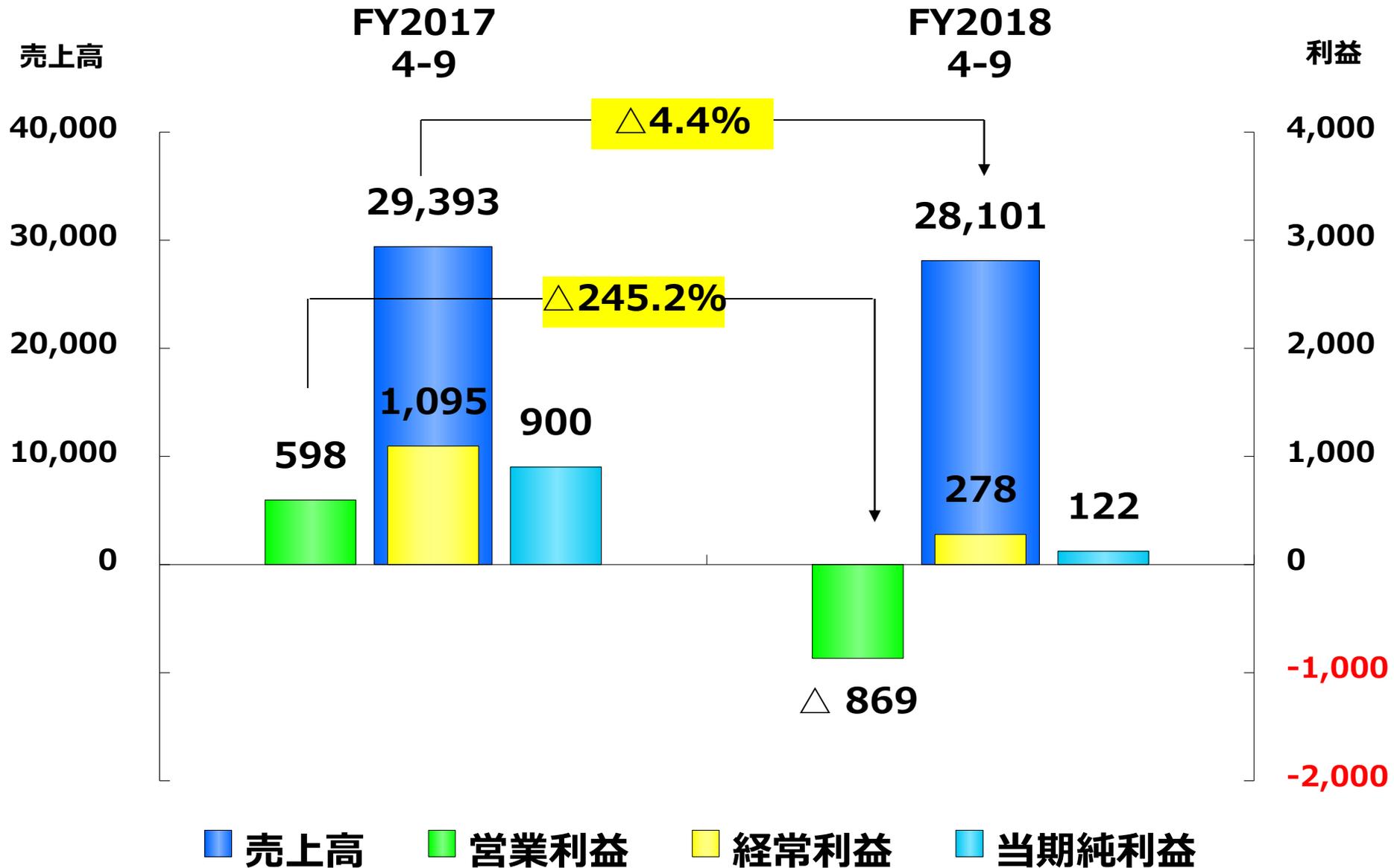


# FY2018 2Q決算の概況

常務執行役員 大垣 幸平

# <連結> 第2四半期業績

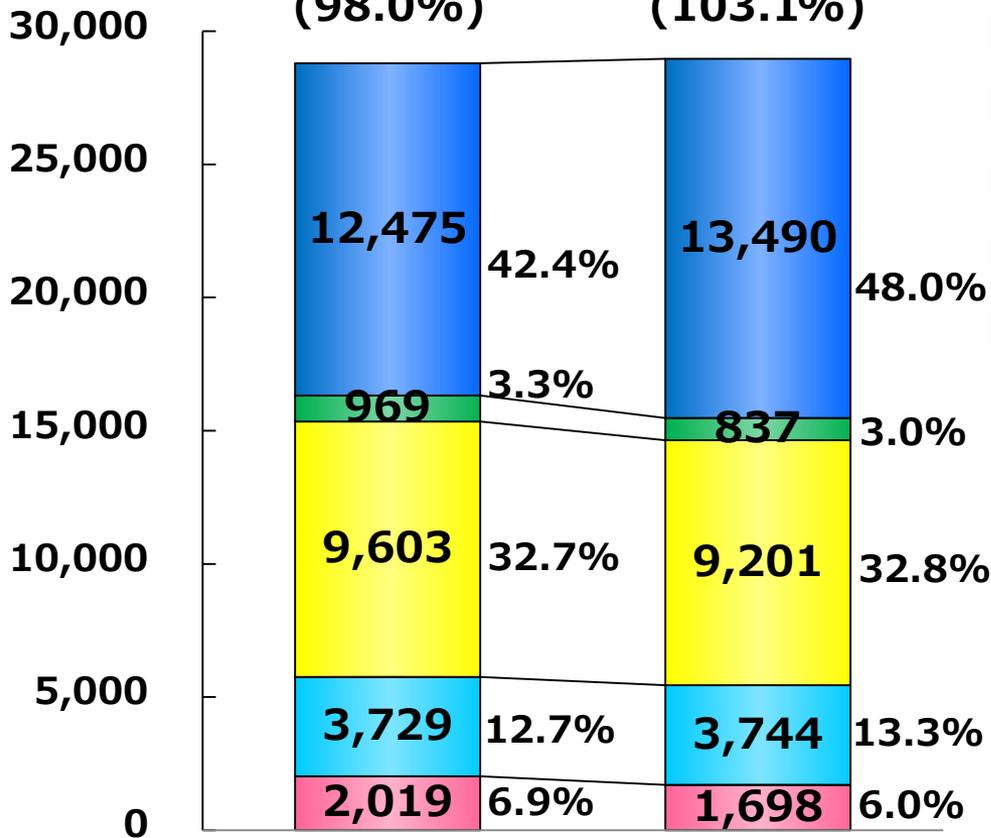
(単位：百万円)



# ＜連結＞ 営業費用

(単位：百万円)

FY2017 4-9 28,795 (98.0%)  
 FY2018 4-9 28,970 (103.1%)  
 ( ):売上比



- 材料費・外注加工費率 5.3%増加  
45.7% → 51.0%  
プロダクトミックスによる材料比率悪化
- 労務費・経費率 0.7%増加  
45.4% → 46.1%  
売上減少による労務費・経費率の増加

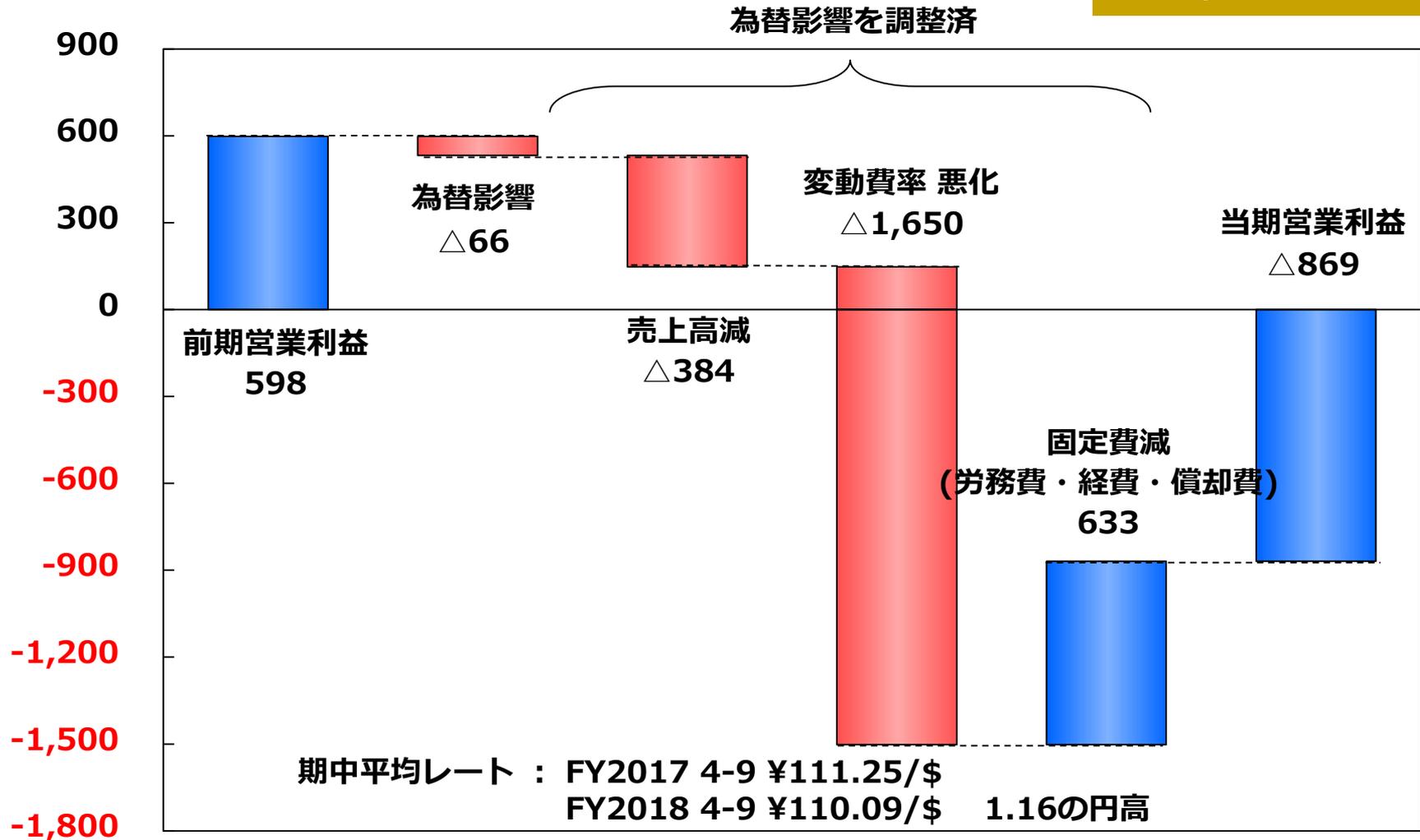
営業利益 598 (2.0%)  
 △869 (△3.1%)

# ＜連結＞ 営業利益分析

(単位：百万円)

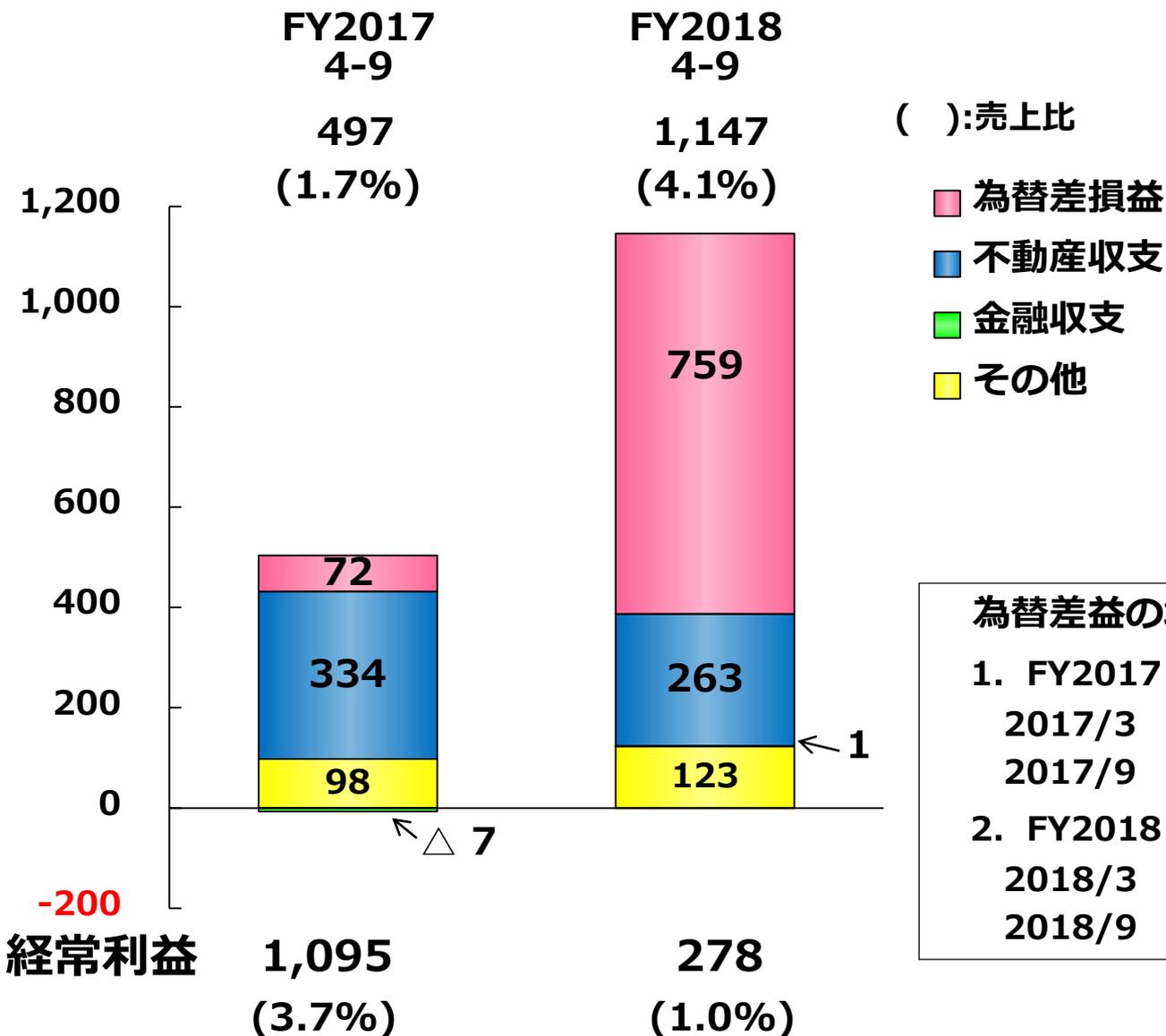
連結営業利益増減要因分析  
[ FY2017 4-9 対 FY2018 4-9 ]

**Total**  
▲1,467百万円



# ＜連結＞ 営業外損益

(単位：百万円)



為替差益の増加 687百万円

1. FY2017 4-9

2017/3 ￥112.19/\$

2017/9 ￥112.73/\$ 0.54の円安

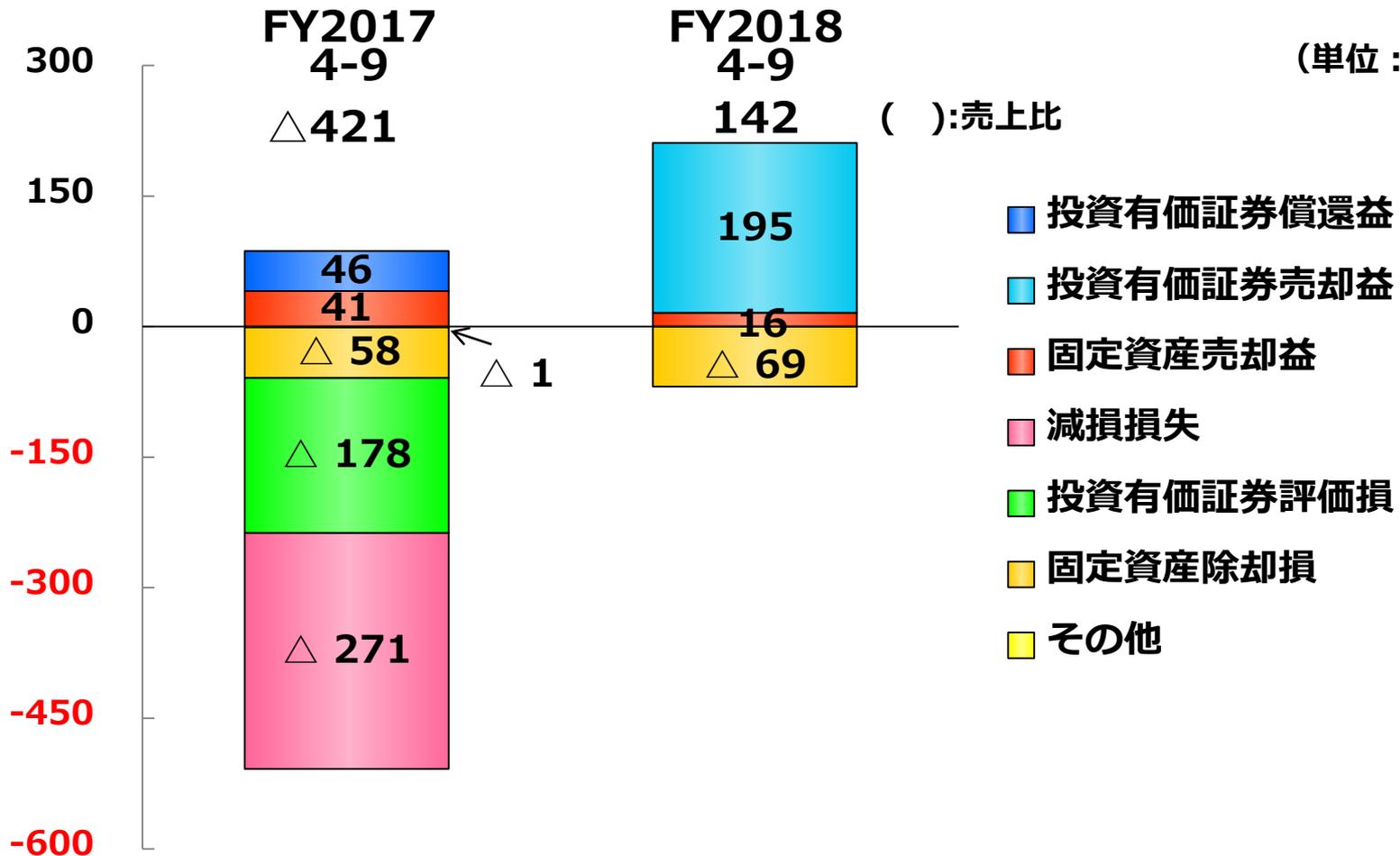
2. FY2018 4-9

2018/3 ￥106.24/\$

2018/9 ￥113.57/\$ 7.33の円安

# <連結> 特別損益

(単位：百万円)



税引前利益

674

420

税金等 (含税効果処理)

212

△297

非支配株主に帰属する純損失

14

—

当期純利益

900

122

(3.1%)

(0.4%)

# <連結>セグメント情報

FY2018 4-9

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	C S事業部	F C事業部	T P事業部	計		
売上高	11,436	11,832	4,635	27,903	197	28,101
セグメント利益 又は損失(△) (営業損失)	51	△508	△325	△782	△87	△869

FY2017 4-9

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	C S事業部	F C事業部	T P事業部	計		
売上高	14,435	9,939	4,857	29,231	162	29,393
セグメント利益 又は損失(△) (営業利益)	1,858	△598	△420	840	△242	598

(注) その他部品事業、リース事業、不動産賃貸事業及び労働者派遣事業

# <連結> 通期業績予想の修正

## • 連結業績予想（通期）

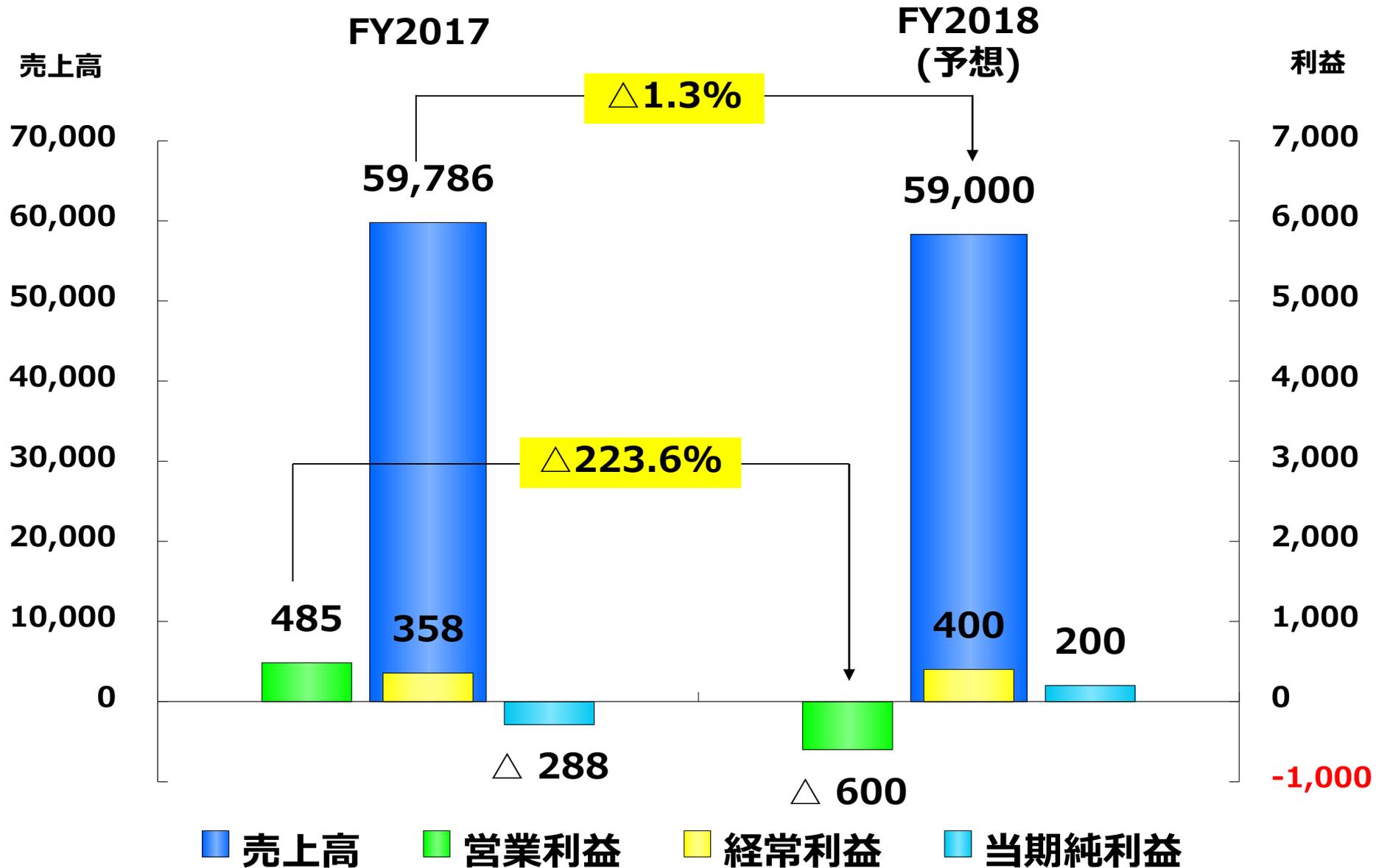
上段：売上高比率

下段：FY2017からの増減率

公表日	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2018/4/26	62,500	100.0 4.5	1,000	1.6 106.0	1,600	2.6 346.4	1,100	1.8 -
2018/10/25 (今回)	59,000	100.0 △1.3	△600	△1.0 -	400	0.7 11.6	200	0.3 -

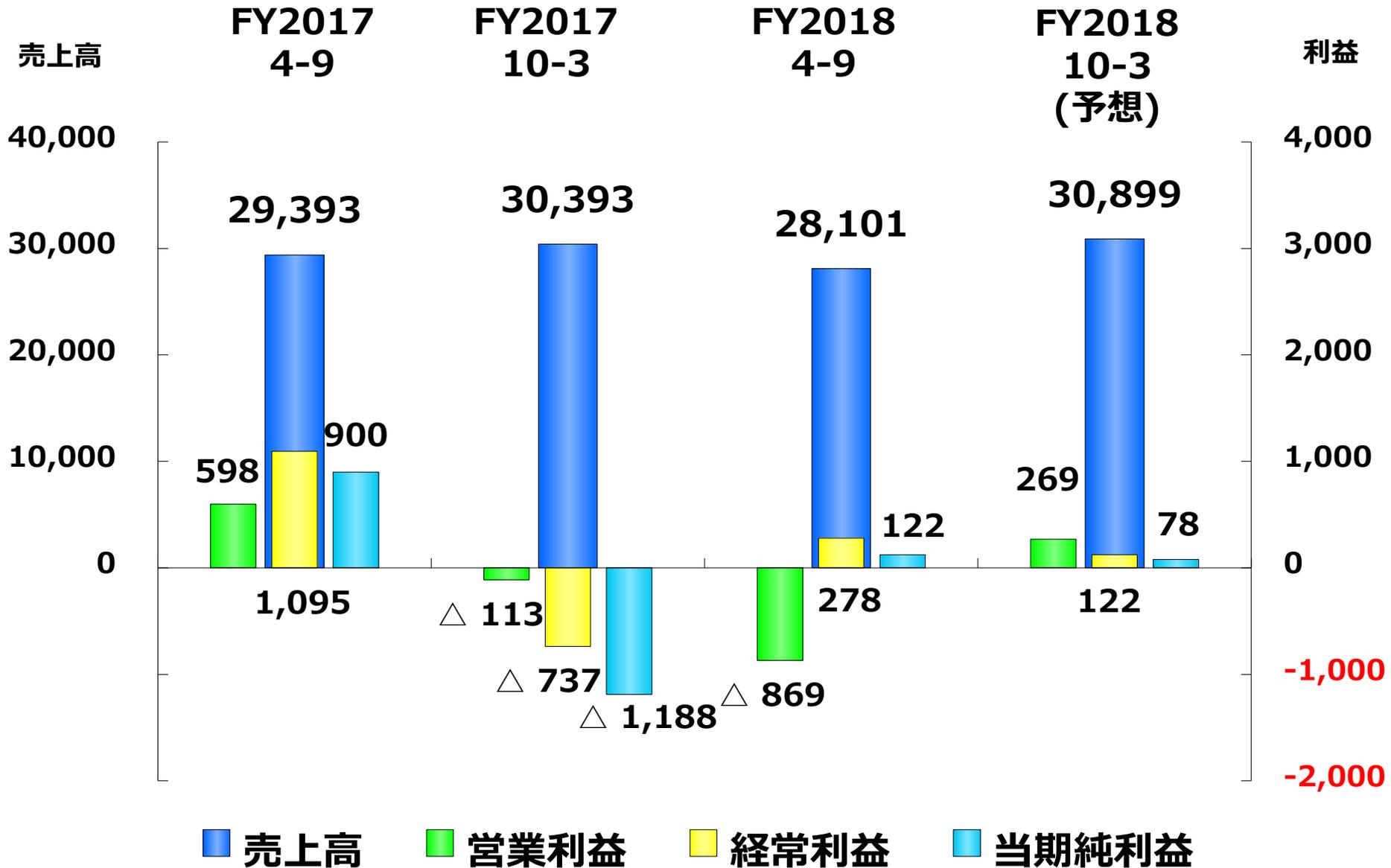
# 〈連結〉業績推移（通期）

（単位：百万円）



# ＜連結＞業績推移（半期）

（単位：百万円）



# <連結> 財政状態

(単位：百万円)

	2018/3 (A)	2018/9 (B)	増減 (B - A)
<b>資産</b>	<b>61,474</b>	<b>61,566</b>	<b>91</b>
現預金	10,599	9,138	△1,460
受取手形及び売掛金	15,251	15,304	53
棚卸資産	8,775	9,016	240
固定資産	25,465	27,083	1,617
<b>負債</b>	<b>30,837</b>	<b>31,116</b>	<b>279</b>
買掛金及び未払金	8,726	7,605	△1,120
有利子負債	17,258	18,680	1,422
<b>純資産</b>	<b>30,637</b>	<b>30,449</b>	<b>△188</b>
資本金	7,996	7,996	-
<b>自己資本比率</b>	<b>49.8%</b>	<b>49.5%</b>	<b>△0.3%</b>

# 〈連結〉 キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

	FY2017 4-9	FY2018 4-9
<b>営業キャッシュフロー</b>	<b>1,959</b>	<b>66</b>
<b>運転資金</b>	△1,206	△1,689
<b>税引前利益</b>	674	420
<b>減価償却費</b>	2,085	1,791
<b>その他</b>	406	△456
<b>投資キャッシュフロー</b>	△1,914	△2,335
<b>フリーキャッシュフロー</b>	45	△2,269
<b>財務キャッシュフロー</b>	<b>697</b>	<b>1,150</b>
<b>有利子負債の増減額</b>	1,029	1,424
<b>自己株式の増減額</b>	△1	△6
<b>配当金の支払金額</b>	△329	△263
<b>その他</b>	—	△4
<b>現金等期首残高</b>	<b>10,011</b>	<b>10,482</b>
<b>現金等期末残高</b>	<b>10,890</b>	<b>9,014</b>

# 年間配当金

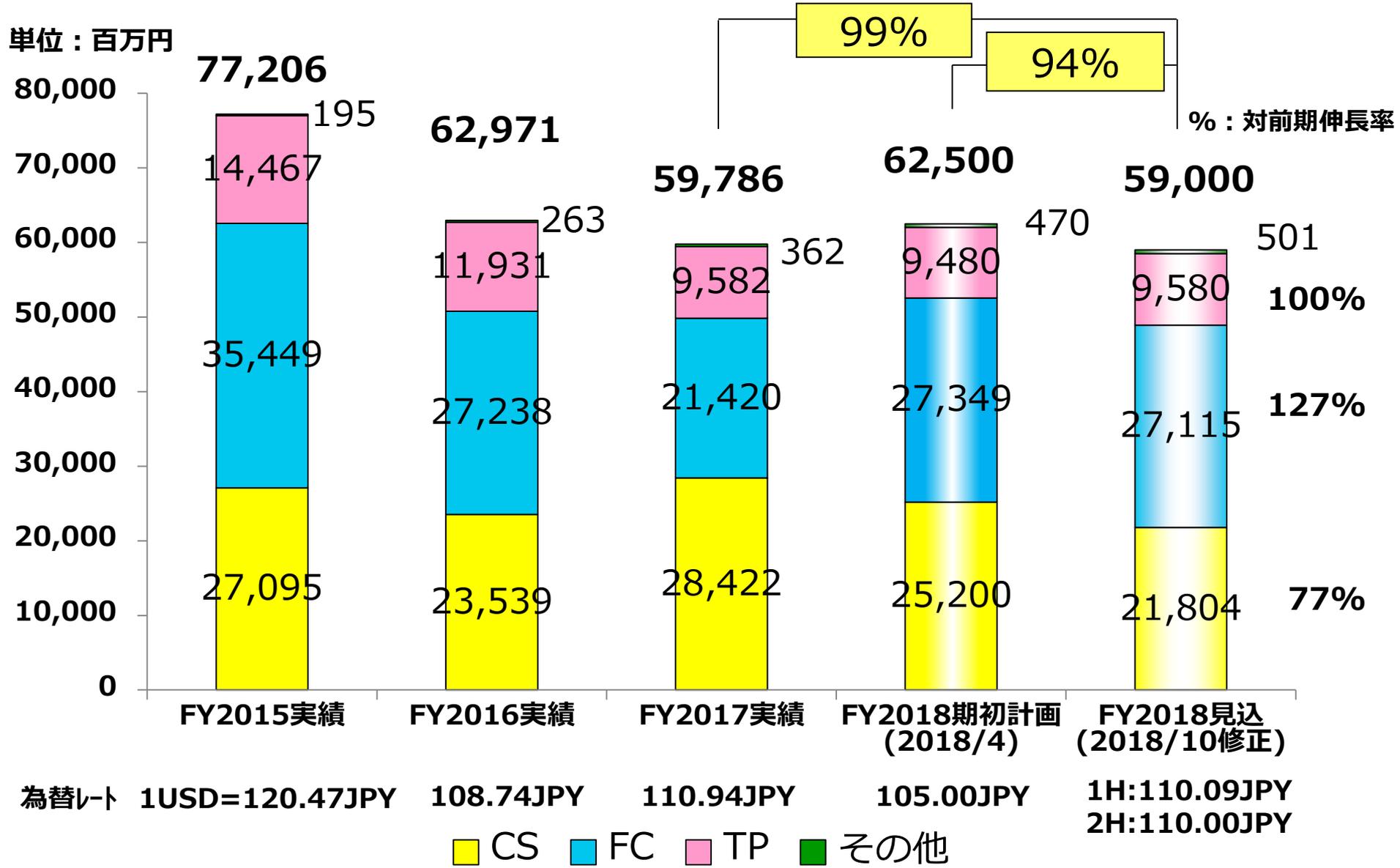
	第2四半期末	期 末	年 間
FY2017 (実績)	4円00銭	4円00銭	8円00銭
FY2018 (実績)	<u>0円00銭</u>	—	—
FY2018 (予想)	—	<u>50円00銭</u>	—

※ FY2018 (予想) は10/1付けの株式併合の影響を考慮した金額を記載。

# FY2018通期見通し

**代表取締役社長 池田 靖光**

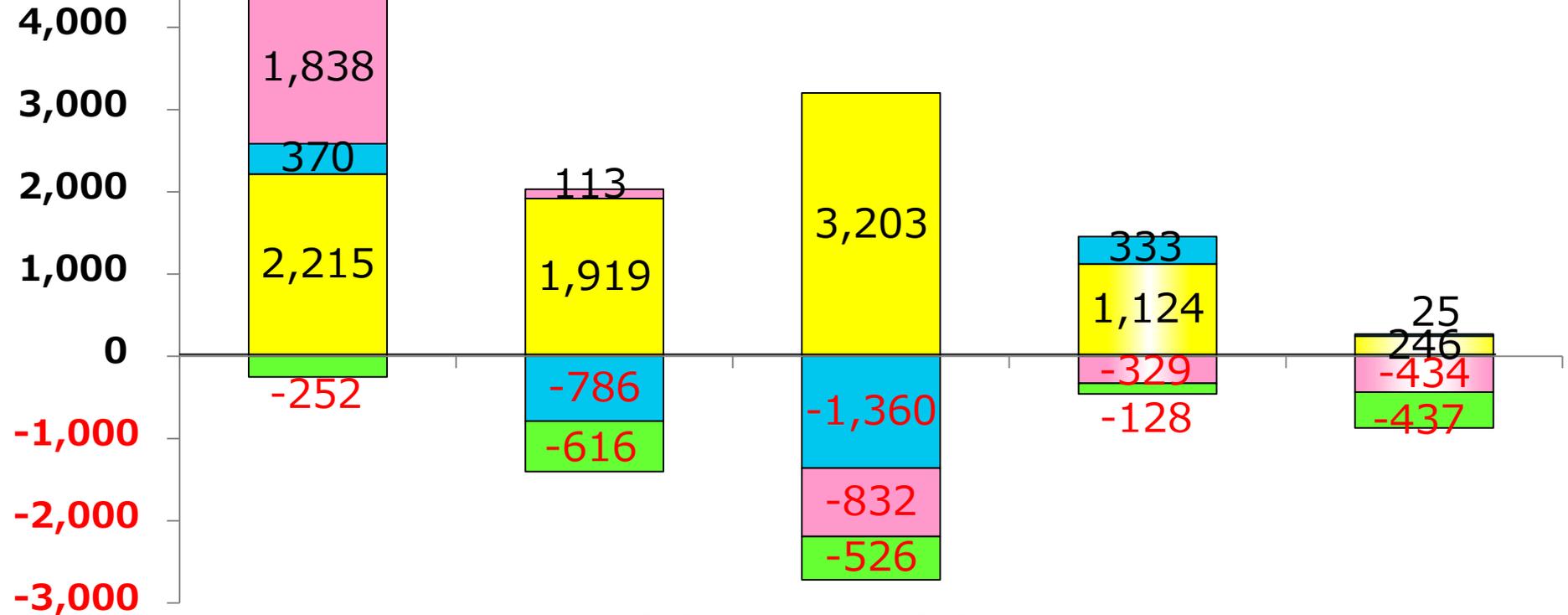
# 事業部別 通期売上高 (FY2015-FY2018)



# 事業部別 通期営業利益 (FY2015-FY2018) <sup>17/24</sup>

利益率% = 利益 / 売上

単位：百万円  
5,000



FY2015実績

FY2016実績

FY2017実績

FY2018期初計画  
(2018/4)

FY2018見込  
(2018/10修正)

為替レート

1USD=120.47JPY

108.74JPY

110.94JPY

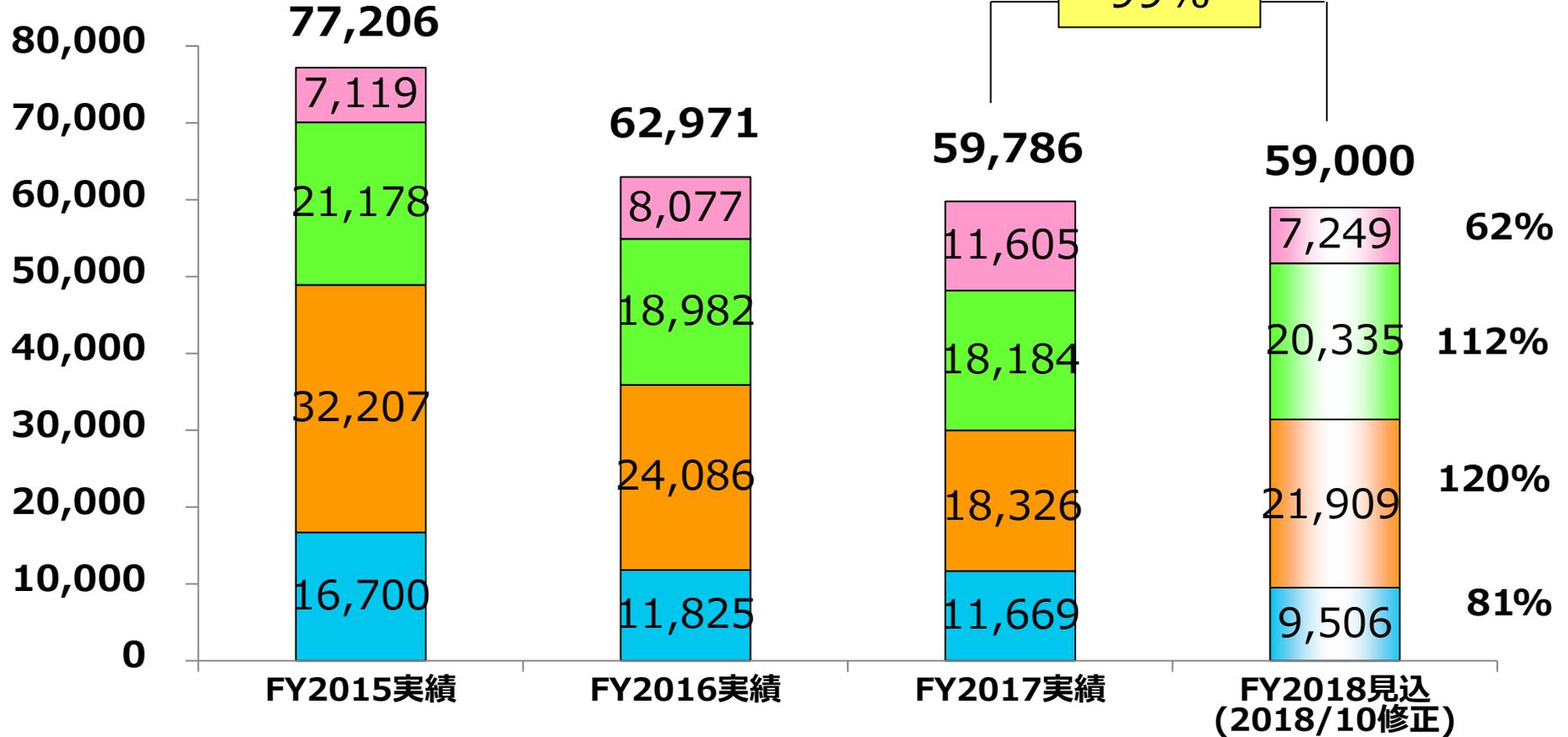
105.00JPY

1H:110.09JPY  
2H:110.00JPY

CS FC TP その他

# 参考:市場別 通期売上高 (FY2015-FY2018)<sup>18/24</sup>

売上高: 百万円



為替レート 1USD=120.47JPY      108.74JPY      110.94JPY      1H:110.09JPY  
 2H:110.00JPY

■ 情報通信   ■ 家電   ■ 車載   ■ 産機・その他

## 1. 短期的な収益力向上

- 不採算ビジネス・赤字事業所の改善
- 新規大型受注商談の確実な立ち上げ
- 生産性の向上、車載品質の確保

## 2. 中長期的な成長の実現

- 新規市場の開拓、新規事業の創出
- オープンイノベーションの実現

## 【日本】

- ① 本社圏の再編
  - 大崎オフィスの本社編入
  - 開発センター・事業戦略室の統合
- ② 労務費・経費削減
- ③ 保有資産の売却

## 【日本／海外共通】

- ① 赤字ビジネスの損益改善策フォロー
- ② 構造改革の推進
- ③ 不採算ビジネスからの撤退
- ④ 生産性/品質の向上、現場不良の削減、CD/VA活動強化

# LPWA関連ビジネスへの取り組み

## Sigfox

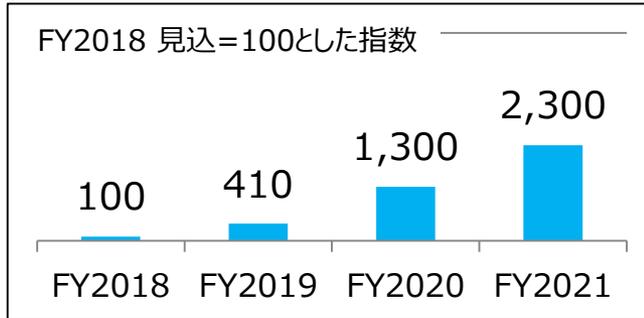


## LoRaWAN™



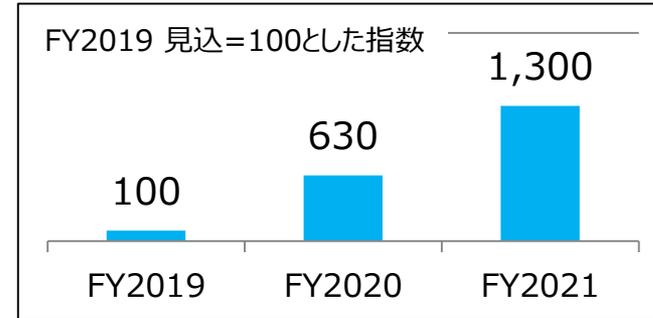
WF931シリーズ

### 【SMK売上高推移】



LR01シリーズ

### 【SMK売上高推移】

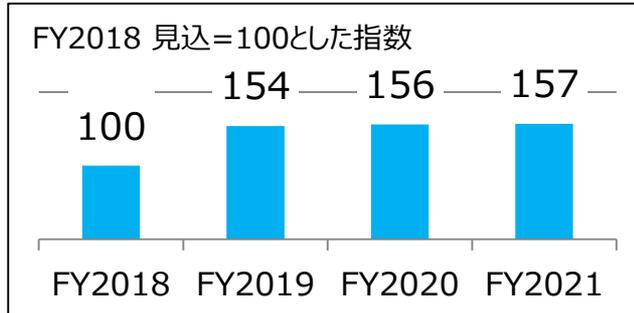


## SMK独自方式



WF924シリーズ

### 【SMK売上高推移】

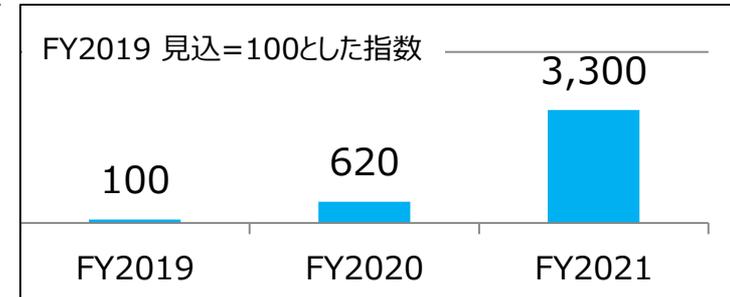


## IP500™



CNXシリーズ

### 【SMK売上高推移】



# 内閣府事業PRISM (官民研究開発投資拡大プログラム) 22/24

総務省 富士通 SMK 北陸先端科学技術大学院大学

2018年PRISM採択手交式

2016年度 (95期) 完了

ECHONETLite™センサー  
(工場環境用10種類)

運用管理機能開発 (有線)

2017年度 (96期) 完了

異常検知機能搭載電源  
モジュール

管理運用機能 (有線)

2018年度 (97期) 実施中

工場用センサデバイス  
(防水・小型)

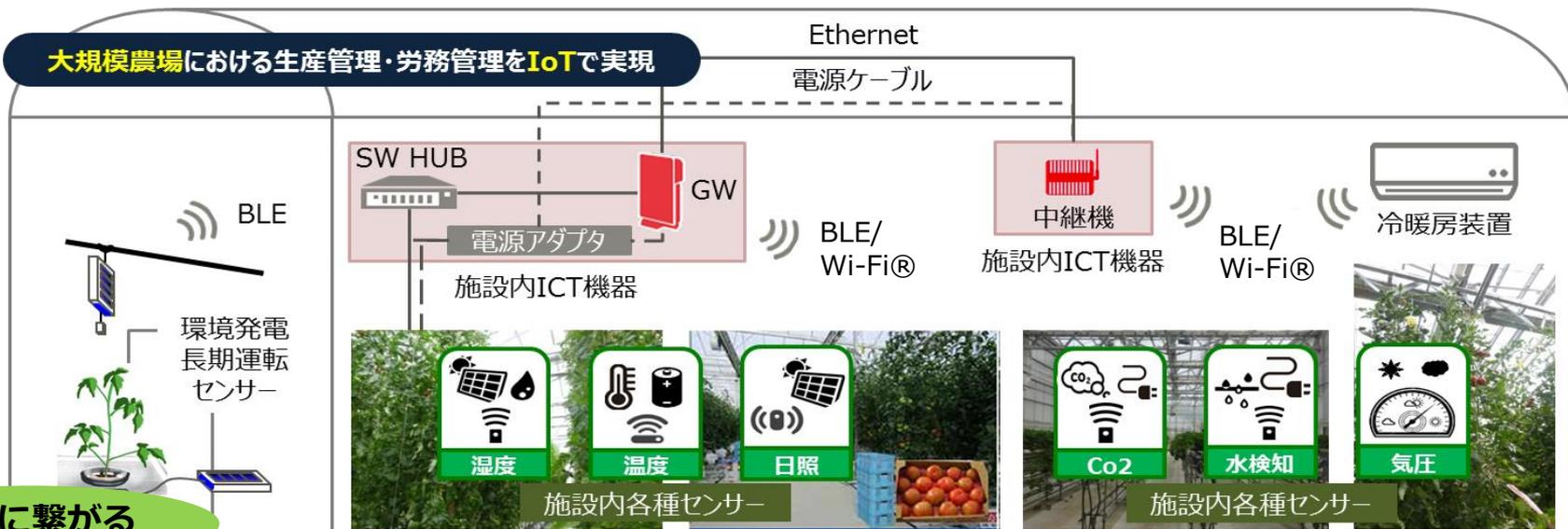
管理運用機能 (IoT機能)

運用管理技術利用



2018年 PRISM 農業分野でのデバイス・オープンシステム開発受託決定

大規模農場における生産管理・労務管理をIoTで実現



簡単に繋がる

長く使える

メンテナンスを  
楽にする

センサデバイスを農業施設に設置すると  
自動的に設定され3年以上動作する  
→メンテナンス管理も可能

標準化へ

# 先行開発展2018

## <会期>

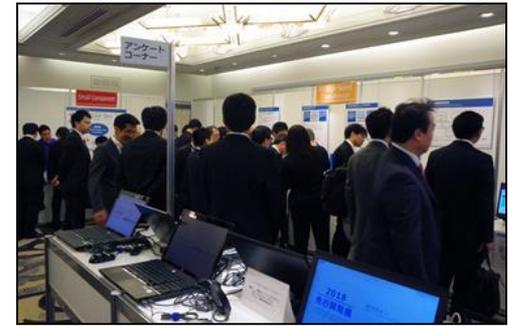
2018年10月17日(水)～19日(金)

## <会場>

ホテルニューオータニ幕張2F 中宴会場ステラ

## <目的>

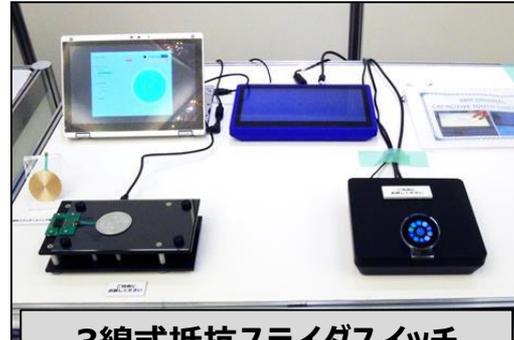
- 1 プライベートショーで、限られた顧客を招待
- 2 未公開の新製品、新技術、新サービスの紹介



来場者数	引合い件数
543名	88件



2メガピクセル  
60fps カメラモジュール



3線式抵抗スライドスイッチ  
円形状



光モジュールコネクタ  
AOC タイプ



静電容量方式タッチスイッチ  
3D形状スイッチパネル



エナジーハーベスト  
センサーユニット

# 注意事項

この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時点において当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。

しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別の事情の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じる可能性があります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の業績見通しのみで全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

## 商標について

- \* Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、SMK株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- \* ECHONETLite はエコーネットコンソーシアムの商標です。
- \* LoRa® および LoRaWAN™は Semtech Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- \* USB Type-C™ は、USB Implementers Forumの商標です。
- \* Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- \* ZigBeeはZigBee Alliance の商標または登録商標です。
- \* その他記載されている社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。